



# EXPERT 10.6 RS

Reworkstation mit 5300 W

Halbautomatische Reworkstation mit Gantry-System für kleine bis sehr große und große Bauteile. Die bewährte Hybrid-Unterheizung ermöglicht schonende Erwärmung von Platinen bis zu 500 x 500 mm<sup>2</sup>. Für sichere Handhabung navigiert das präzise Positionie-

rungssystem mühelos zu jedem Punkt auf der Leiterplatte. Die Vorpositionierung erfolgt über das XY-Gantry-System, während die präzise Feinjustierung und automatische Platzierung vollständig integriert sind.

## Top Features

Kameragestütztes Rework



### Flexibilität

Gute Erreichbarkeit aller Komponenten auf der Platine über das Gantry-System & gleichzeitig kompakte Stellfläche



### Multifunktionalität

Alle Prozesse an einem Gerät: Lot Absaugen, autom. Positionierung, Löten und Entlöten



### Unterheizung

Große PCBs 500 x 500 mm<sup>2</sup>



### Prozesskontrolle

Automatischer Profiler für Unter- und Oberheizung;



### Performance

Hohe Taktzeit durch einfache Vorpositionierung des Arms über das Gantry-System



### Software

einfach, intuitiv, Tablet kompatibel

## Ausstattung

- Satz Bestück-Pipetten XL (BGA/CSP) 5 mm, 8 mm, 15 mm mit O-Ring
- Satz Löt-Werkzeuge (BGA) 15 mm, 27 mm, 35 mm, 40 mm
- Zwei Objektive (BGA und CSP)
- Zwei Sensoren (Typ K) für Temperaturmessung
- Vier Leiterplatten-Magnethalter 40,5 mm (Standard)
- Zwei Leiterplattenklammern zur Montage an der Handauflage
- Betriebsanleitung
- Intuitive touchfähige Software EASYSOLDER 07


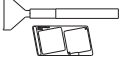
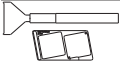
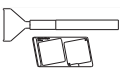

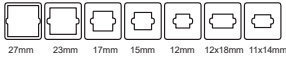

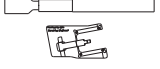


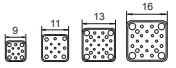
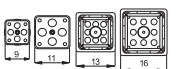
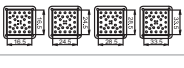
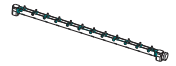
## Technische Details

<b>Gesamtleistungsaufnahme:</b>	5500 VA	
<b>Leistung Lötgriffel:</b>	400 W, 35 l/min	
<b>Leistung Unterheizung:</b>	1200 - 5000 W	8 x IR-Lampen
<b>Größe Unterheizung:</b>	420 x 450 mm <sup>2</sup>	
<b>Empf. max. Leiterplattengröße:</b>	500 x 500 mm <sup>2</sup>	
<b>Auflösung Positionierachsen:</b>	0,001 mm	
<b>Platziergenauigkeit:</b>	± 0,015 mm	(Flip Chip)*
	± 0,030 mm	(CSP)
	± 0,040 mm	(BGA)
	± 0,070 mm	(Maxi BGA)*
	± 0,115 mm	(Maxi BGA XL)*

<b>Hochaufl. CMOS-Kamera:</b>	5 Mio. Pixel USB2	
<b>Bildausschnitt:</b>	16 x 22 mm <sup>2</sup>	(Flip Chip)*
	32 x 42 mm <sup>2</sup>	(CSP)
	42 x 57 mm <sup>2</sup>	(BGA)
	71 x 96 mm <sup>2</sup>	(Maxi BGA)*
	115 x 160 mm <sup>2</sup>	(Maxi BGA XL)*
<b>Elektrischer Anschluss:</b>	1Phase, 230VAC, 25A	
	Stecker CEE 32A (3-phasig)	
<b>Pressurized air:</b>	5-8 bar, 100 l/min	gereinigte, trockene Luft
<b>Dimensions:</b>	1030 x 630 mm <sup>2</sup>	

\*Ergänzungsbaustein

## EXPERT 10.6 RS: Ergänzungsbausteine

	Article nr.	Name
	SF66.0501	Tool Slider 40 für AVP 4.1XL
	SF64.0525	Dipp Tool 0,08mm mit Rakel für Tool Slider 32 / 40
	SF64.0526	Dipp Tool 0,15mm mit Rakel für Tool Slider 32 / 40
	SF64.0527	Dipp Tool 0,22mm mit Rakel für Tool Slider 32 / 40
	SF66.0526	Dipp Tool 40x0,15mm mit Rakel nur für Tool Slider 40
	AT10.0100	Chip Rahmen Set Dipp Tool 7 / 32*32mm 7 Stück (11x14,12x18,12,15,17,23,27)
	AT20.0100	Chip Rahmen Set Dipp Tool 7 / 40*40mm 7 Stück (15,17,23,27,31,35,37,5)
	SF64.0520	Print Tool mit Rakel für Tool Slider 32 / 40
	DB00.0025	Stickstoff-Anschluss DBL-04/05/06 (2.D.M) verringert N2-Verbrauch bei Vakuum
	SF66.0110	Objektiv Maxi-BGA für AVP4/4XL, f=16mm, 65*85mm
	LW40.1096	Löt-Werkzeug-Set-CSP/QFN für alle CSP-Typen, 4 Stück (9, 11, 13, 16)
	LW40.1104	Löt-Werkzeug-Set CSP mit Vakuum für alle CSP-Typen, 4 Stück (9, 11, 13, 16)
	LW40.1099	Löt-Werkzeug-Set BGA 7 7 Stück (15, 23, 27, 31, 35, 37.5, 40)
	SF36.1002	Leiterplatten-Flex-Unterstützung 40,5 für HIF-9-Strahler, 12-Punkt-Kissen

Weiteres Zubehör und Verbrauchsmaterial unter [www.martin-smt.de](http://www.martin-smt.de)